

2013 IEEE International Interconnect Technology Conference (IITC);  
2013年多層配線技術国際会議へのスポンサーの募集について

電子情報産業の飛躍的發展を支えるULSIの多層配線技術およびTSV・3次元構造を含む実装技術は、配線材料の物性や構造のみならず、それらの選択、インテグレーション手法、信頼性評価、さらには、将来の配線技術の候補となるERM(Emerging Research Materials)など、多岐に亘る技術を扱う分野として、これからも不可欠なものと考えられています。

本国際会議は銅・低誘電率多層配線構造の台頭と時を同じくし、1998年にIEEE Electron Devices Societyの協賛の下、第1回会議が米国・サンフランシスコ空港近郊のパーリングゲーム市にて開催されました。2009年からは開催地を欧州・アジア、北米間を往来することとなり、2009年は札幌、2011年はドイツ・ドレスデンで開催され、2013年は再び日本に戻り、京都で開催されることが決まりました。これは、配線技術に対する日本の関心の高さが評価されたものであり、この京都會議を是非とも成功させる必要があります。本会議では、関連する国内外の大学、研究機関、産業界の研究者、技術者が一同に会し、材料物性、微細構造物性、これらの制御、評価、信頼性などに関して、理論、実験両面から議論を重ねる場とし、この分野の今後の学問的、技術的進展に寄与していきたいと考えております。

本会議では、この業界でともに活動を進める皆さんと強力な信頼関係を築くべく、広く装置・材料メーカー様を始めとして、関係企業の皆様にスポンサーをお願いする次第です。

今回のスポンサーの負担金は、一口200,000円とさせていただきます。別表のように、抛り出いただいた口数に応じ、展示ブース、サプライヤーセミナールーム、謝辞ボードの表示、学会参加割引等を用意しております。詳しくは下記をご参照ください。

スポンサーにご賛同いただける方は、お申込書を下記事務局までお送りください。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

IITC 2013 実行委員長 小川 真一(産業技術総合研究所)  
IITC 2013 Supplier Relation アジア地区担当 内堀 千尋(富士通研究所)

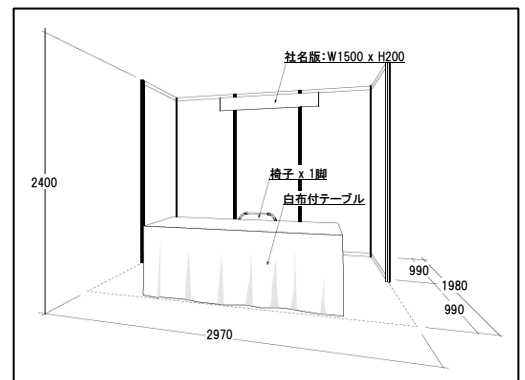
**スポンサーシップ概要**

- 学会の名称: International Interconnect Technology Conference (IITC) 2013
- 開催日: 2013年6月13日(木)~15日(土)
- 開催場所: 京都リサーチパーク(京都市下京区中堂寺南町134番地)
- 展示場所: IITC 2013メイン会場隣接
- 展示時間: 2013年6月13日(木)12:10~18:10、14日(金)9:00~18:00、15日(土)9:00~12:00

抛り出口数と特典: 口数に応じて、以下のような特典を用意させていただきます。

口数	1口	2口	3口
スポンサー料金	200,000円	400,000円	600,000円
展示ブース(右図参照ください)	ブース(間口3m)一つ用意。	ブース(間口3m)を二つ用意。	
謝辞(展示を希望されない場合を含みます)	ご協力頂いた旨を学会のオープニングセッションで紹介。		ご協力頂いた旨を学会会場に掲示(ただし、口数により、掲示場所、期間は異なります)。
セミナー会場	会場を用意(費用は別途お支払いください)。ただし数に限りがありますので、お早めにお申し出ください。セミナー開催は必須ではありません。		
学会参加	1名様無料		2名様無料
参加者リスト	学会参加者の氏名とe-mailアドレスをお知らせします。		
予稿集等への御社名掲載	プロシーディングス(あるいはWebsite)への掲載		

**Exhibitor Booth イメージ図**  
(寸法は多少変わることがあります)



展示をされる場合およびサプライヤーセミナーを開催される場合は、メールリストでIITC参加者にその開催の旨がアナウンスされます。

問合せ先: IITC 2013 事務局 株式会社セミコンダクタポータル内  
Tel: 03-3560-3565  
Email: [IITC\\_2013@semiconportal.com](mailto:IITC_2013@semiconportal.com)  
<http://www.semiconportal.com/IITC2013/>